

ピラーフロロゴールドの特長

●低摩擦係数

ピラフロン同士やSUS特殊研磨板との組み合わせによって得られる摩擦係数(μ)は非常に小さく低速下では0.06程度となります。

●自己潤滑性

ピラーフロロゴールドは自己潤滑性があり給油の必要もありません。基本的にはメンテナンスフリーで長期にご使用いただけます。

●耐 候 性

ピラフロンは耐候性に優れ、広い温度範囲で使用することができます。氷点下でも安定しており吸水率は0.01%以下です。

●耐 薬 品 性

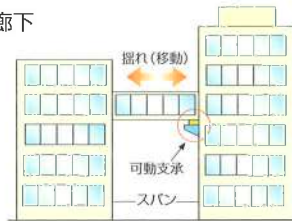
ピラフロンは化学的に不活性で、ほとんどの薬液と反応しません。したがって、海に隣接する地域でも安心してご使用いただけます。

●コンパクト

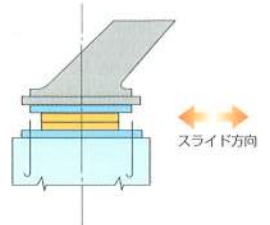
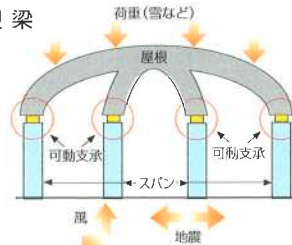
ピラフロンは厚み2.4mm、鉄板の厚み3.2mmを標準としております。TOTAL厚みは5.6mmと非常にコンパクトですので容易に設計いただけます。

使用箇所

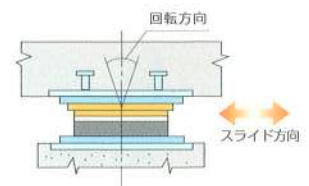
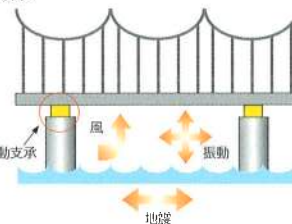
渡り廊下



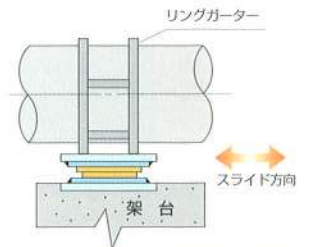
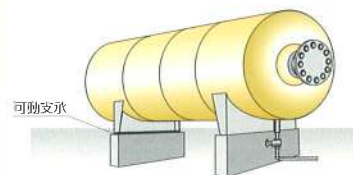
屋根梁



橋梁関係



石油化学・プラント関連



主な実績

建築関連

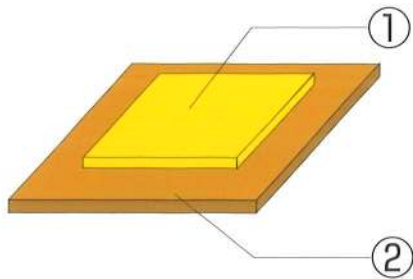
- 大阪駅前第3棟改造ビル(カーテンウォール、走行車路用支承)
- 芦屋浜高層住宅街建設工事(構造壁、渡り廊下)
- 神戸ポートピアホテル(渡り廊下)
- 春日井市室内温水プール(屋根梁)
- 長野県松本市総合体育館(屋根梁)
- 東京都健康プラザ新築工事(エキスパンション)
- 東京国際空港国際線ターミナル(エキスパンション)
- 博多ベイオリエンタルホテル&リゾート(エキスパンション)
- 関西国際空港旅客ターミナル(渡り廊下)
- 兵庫県立美術館(エキスパンション)
- 名古屋市犬山センジン立体駐車場(エキスパンション)
- 沖縄県総合福祉センター(エキスパンション)
- 東京宝塚ビル(エキスパンション)
- 三浦体育館(屋根梁)
- 東仲ノ町再開発事業(渡り廊下)
- 東京国際フォーラムガラス棟(エキスパンション)

プラント・土木関連

- 新日鐵君津四号送風機(配管支承)
- 神戸製鋼所神戸発電所(電気集塵機架台)
- 関西電力舞鶴発電所(煙道サポート)
- 明石海峡大橋(配管支承)
- GLENDALE FREEWAY Los Angeles(車道支持)
- BARKA POWER & DESALINATION PROJECT(エキスパンション)
- 日本原燃料六ヶ所再処理設備DA建屋(エキスパンション)
- 廃プラ及び汚泥ガス化溶融発電設備(エキスパンション)
- 中国/宝山鋼鐵(装置架台)
- 王子製紙米子工場(ボイラ架台)
- マレーシャワラクLNGプラント(パイプラインサポート)
- 知多LNG基地(パイプラインサポート)
- 新東京国際空港公団(航空燃料パイプラインサポート)
- アルジェリアハッシルメルガスプラント(パイプラインサポート)
- 中国/三河発電施設(ボイラ架台)
- Mobil Oil singapore Pte.,Led.(パイプラインサポート)

ピラーフロロゴールドの仕様

標準仕様



	材質・仕様	備考
① ベアリング	ピラフロン®	厚み:2.4mm
② 台 金	SS400	厚み:3.2mm
塗 装	シアナミド鉛さび止め塗料	JIS K5625

※上記以外の材質、厚み、塗装についても対応可能ですのでご指示ください。

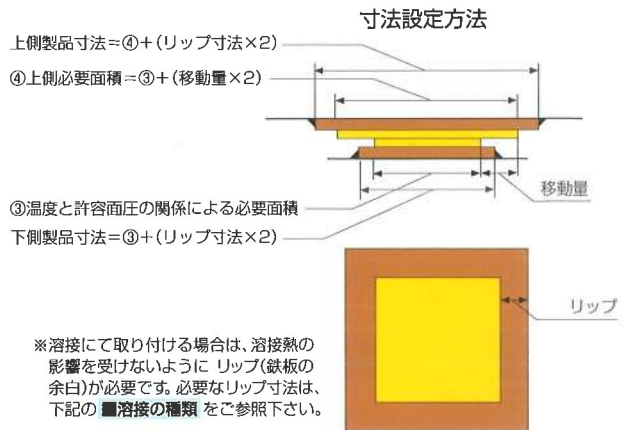
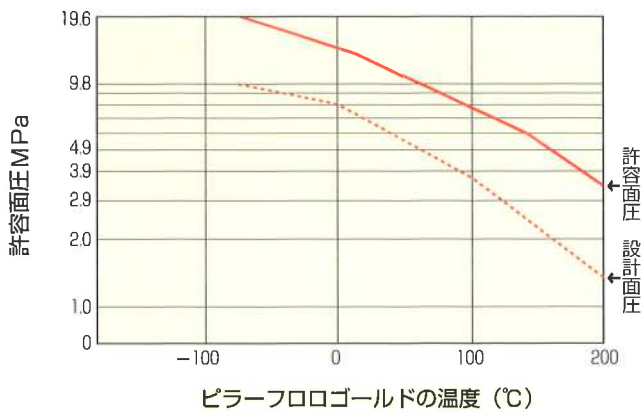
タイプ・使用方法

標準タイプ	使用方法	略 図
標準品① フロロゴールド vs SUS304特殊研磨板	厚み2.4mmのピラフロンをSS400の台金に15mmのリップを残して接合したフロロゴールドと、SUS304特殊研磨板との摺動組み合わせ。最も一般的な使用方法です。 面圧：0.5MPa～13.7MPa 温度：-60℃～+200℃	
標準品② フロロゴールド vs フロロゴールド	厚み2.4mmのピラフロンをSS400の台金に15mmのリップを残して接合したフロロゴールド同士の摺動組み合わせ。特に取付け部の平面スペースが取れない場合に適します。 面圧：0.5MPa～13.7MPa 温度：-60℃～+200℃	
特殊タイプ	使用方法	略 図
ダストシール付き	標準品①のフロロゴールドに防塵用のダストシールを取付けたもの。粉塵が多い環境にご使用ください。 面圧：0.5MPa～13.7MPa 温度：-45℃～+100℃	
裏溶接タイプ	標準品②と同様な組み合わせですが、裏溶接をする場合は台金の厚みが19mmとなります。 面圧：0.5MPa～13.7MPa 温度：-60℃～+200℃	
ビス止めタイプ	ビス止め用の皿ビス穴加工をしたもので、台金の厚みが4.5mmとなります。被取付け部が溶融亜鉛メッキなどで現場溶接ができない場合は、ビス止めタイプになります。 面圧：0.5MPa～13.7MPa 温度：-60℃～+200℃	
ゴム付きフロロゴールド	2.4mmのピラフロンをステンレス板で挟んだクロロブレンゴムに接合したもの。高さ寸法は個別設計により決定いたします。 面圧：0.5MPa～4.9MPa 温度：-30℃～+100℃	
LBPスライドベアリング	0.8mmのピラフロンと0.8mmのパンチングステンレス板とを接合し、3mmのステンレス板に溶接にて取付けたもの。機器などの高荷重用スライドベアリングとしてご使用ください。 面圧：0.5MPa～34.3MPa 温度：-60℃～+200℃	

設計手順

- ① ピラーフロロゴールドにかかる荷重、温度、移動量を算出してください。
- ② ピラーフロロゴールドの取り付け方法を決めてください。
- ③ 温度と許容面圧の関係から、下側のピラーフロン面積（寸法）を決めてください。
全面に一樣な接触が期待できない場合には、設計面圧以下（安全率を2以上）でご使用ください。
- ④ 移動量によって上側のベアリングプレートの面積（寸法）を決めてください。

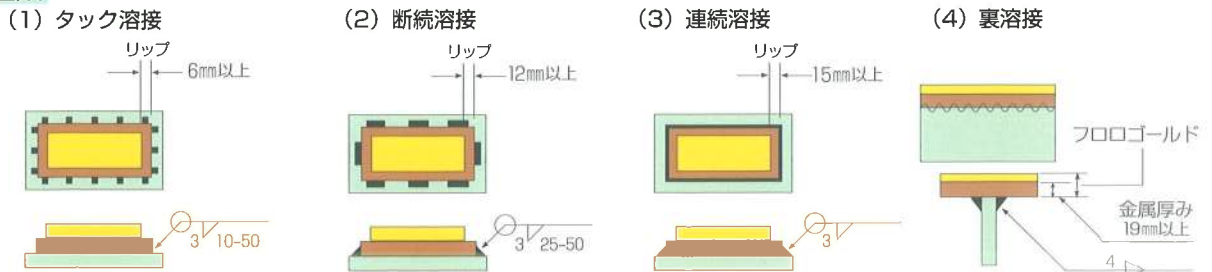
ピラーフロロゴールドの温度と許容面圧・設計面圧の関係



取り付けのご注意

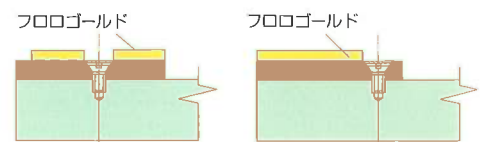
- 溶接前の準備
- ピラーフロロゴールドが据え付けられる座面を清掃してください。
 - 溶接直前には、ピラーフロロゴールドの溶接部の塗装、水分、ごみ、油などの溶接に悪影響をおよぼすものを除去してください。
- 溶接
- 溶接棒は3.2mm以下のものをご使用ください。2.6mmが最適です。
 - 溶接時は摺動面へのスパッタの付着を避けるため、ピラーフロロゴールドに重ねて包装しているソフトペーパーを軽く水に濡らして、フロロゴールド面を保護しながら溶接してください。(濡らしたウェスでも充分です)
 - ガス溶接はしないでください。
 - タック溶接、断続、溶接の場合は、溶接後に取り付け相手材との間に雨水などが侵入しないよう、外周部にシーラントを施してください。

■溶接の種類



■ビス止め・ボルト締め

- ネジあたまが摺動面にでないように注意してください。
- 取り付け後、取り付け相手材との間に雨水などが侵入しないよう、外周及びビス頭の外周部にシーラントを施してください。



■塗装

鋼板面はJIS K5625シアナミド鉛錆止めペイントで塗装しています。溶接時には、ピラーフロロゴールドの溶接部の塗装を除去し、溶接してください。取り付け後、補修および仕上げ塗装願います。右図のように、特に円内は丁寧に行ってください。

